

各 位

会 社 名 京セラ株式会社
代表者名 取締役社長 山口 悟郎
(コード番号 6971 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 執行役員常務 青木 昭一
(TEL (075) 604-3500)

株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズに関する株式譲渡契約の締結について

京セラ株式会社（以下 京セラ）は、当社グループの有機基板事業のさらなる強化、拡大を図るため、プリント配線板メーカーである株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズ（本社：東京都港区、社長：宮島 恵二、以下 TNCSi 社）の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。本日、京セラ、および凸版印刷株式会社、日本電気株式会社の 3 社で株式譲渡契約を締結しましたのでお知らせいたします。

本件の概要は以下のとおりです。

1. 内 容 : 株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズに関する株式譲渡契約
2. 契約締結者 : 京セラ株式会社、凸版印刷株式会社、日本電気株式会社
3. 締結日 : 平成 25 年 8 月 6 日
4. 当該会社概要 : 社名 株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズ
株主 凸版印刷株式会社 55%、日本電気株式会社 45%
業容 産業用高多層基板、民生用ビルドアップ基板、モジュール基板
5. 今後の予定 : 平成 25 年 10 月 1 日 ・ TNCSi 社の全株式を京セラ株式会社へ譲渡
同日 ・ 京セラ株式会社の 100%子会社化
6. 目的および趣旨 :

プリント配線板の市場は、スマートフォンやタブレット PC を中心としたデジタルコンシューマ機器や通信インフラの需要拡大に伴い、今後も着実に成長していくと予測されています。

京セラグループでは、プリント配線板市場の中の有機パッケージ分野において、当社の 100%子会社である京セラ SLC テクノロジー株式会社が事業を展開しています。業界トップクラスのシェアを誇るハイエンド ASIC 用 FCBGA（フリップチップ・ボールグリッドアレイパッケージ）を主力製品としているほか、今後も高い成長が見込まれるスマートフォンやタブレット PC 向けの小型・薄型の FCCSP（フリップチップ・チップスケールパッケージ）を本格的に立ち上げており、事業の拡大を図っています。

一方、TNCSi 社は、同市場の主にマザーボードの分野において、産業用でハイエンドの通信インフラ向け高多層基板や、スマートフォン向けのモジュール基板、また車載向け基板など、極薄から高多層までの幅広い領域で事業を展開しています。同社は高密度プリント配線板の豊富な品揃えと高度な薄型基板技術を有しており、近年では、スマートフォンなどのさらなる小型薄型化に貢献する、世界最薄クラスの部品内蔵基板を開発しています。

このたびの子会社化により、当社グループはより一層幅広い事業を展開することが可能となり、事業拡大に繋がるものと考えています。

今後は、両社の技術シナジーによってお客様のニーズにあった新製品の開発や、当社グループのグローバルな営業ネットワーク、TNCSi 社の安定した顧客基盤など、両社の経営資源を有効活用することにより、有機基板事業のさらなる強化と拡大を図ってまいります。

<ご参考>

株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズの会社概要

商号	： 株式会社トッパン NEC サーキットソリューションズ
設立	： 平成 14 年 10 月 1 日
本社所在地	： 東京都港区芝浦三丁目 19 番 26 号
代表者	： 代表取締役社長 宮島 恵二
事業内容	： プリント配線板の開発、設計、製造および販売
資本金	： 1,000 百万円
出資比率	： 凸版印刷株式会社 55%、日本電気株式会社 45%
従業員数	： 単体 769 名、連結 1,133 名（平成 25 年 7 月末時点）
主要拠点	： 生産拠点 日本（新潟、富山）、フィリピン 販売拠点 日本 4 箇所（東京（芝浦、府中）、名古屋、大阪） 海外 2 箇所（米国サンディエゴ、米国サンノゼ）

将来予想に関する注意事項：

この資料に記載されている記述には、1934 年米国証券取引所施行 21E 条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。かかる将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものです。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 当社の主要市場である日本、北米、欧州及びアジアの経済状況
- (2) 当社が事業を行う国及び地域における経済・政治・法律面の諸条件及びその想定外の変化
- (3) 円高、政治・経済情勢、関税及び不十分な知的財産権等の保護等が当社製品の輸出に及ぼす影響
- (4) 為替レートの変動が当社の海外資産の価値又は製品価格に及ぼす影響
- (5) 製品価格、技術革新、製品開発、品質、納期等の面における競争の激化
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 電力不足や電力費の上昇が当社の生産活動及び販売活動に及ぼす影響
- (8) 生産及び開発能力の拡大又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態
- (9) 買収した会社又は取得した資産から期待される成果や事業機会が得られない事態
- (10) 科学技術分野等の優れた人材の確保が困難となる事態
- (11) 当社の企業秘密が漏洩又は知的財産権が侵害される事態
- (12) 当社が知的財産権侵害に関連する要求又は特許実施許諾料の請求を受ける可能性
- (13) 国内外の環境規制による賠償責任の発生及び関連費用の負担
- (14) 意図しない法規制への抵触又は想定していない法規制の導入が当社の事業活動を制約する状況
- (15) テロ行為、疾病の発生等が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす悪影響
- (16) 地震等の自然災害及びこれに付随する災害によって当社の事業関連施設、サプライヤー及び顧客、並びに社会資本及び経済基盤等が甚大な被害を受ける事態
- (17) 当社の顧客の財政状態の悪化により売掛債権の回収が困難となる事態
- (18) 当社が保有する投資有価証券等の時価の下落に伴う減損処理の可能性
- (19) 当社の長期性資産、営業権、無形資産の減損処理の可能性
- (20) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (21) 会計基準の変更

これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、これらの将来予想に関する記述に明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

以上